

**DIN EN 62258-2****DIN**

ICS 31.080.01; 35.040

Ersatz für  
DIN EN 62258-2:2005-12  
Siehe Anwendungsbeginn**Halbleiter-Chip-Erzeugnisse –  
Teil 2: Datenaustausch-Formate (IEC 62258-2:2011);  
Englische Fassung EN 62258-2:2011**Semiconductor die products –  
Part 2: Exchange data formats (IEC 62258-2:2011);  
English version EN 62258-2:2011Produits de puces de semiconducteurs –  
Partie 2: Formats d'échange de données (CEI 62258-2:2011);  
Version anglaise EN 62258-2:2011

Gesamtumfang 69 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE



## **Anwendungsbeginn**

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2011-06-29 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2011-12-01.

Für DIN EN 62258-2:2005-12 gilt eine Übergangsfrist bis zum 2014-06-29.

## **Nationales Vorwort**

*Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62258-2:2009-10.*

Für diese Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 631 „Halbleiterbauelemente“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE ([www.dke.de](http://www.dke.de)) zuständig.

Da sich die Anwender des vorliegenden Dokuments der englischen Sprache als Fachsprache bedienen, wird der Inhalt dieser Norm in Englisch veröffentlicht. Dies geht auf eine Anregung im Rahmen der Einspruchsberatung zur Norm DIN EN 62258-2:2005-12 zurück, wurde von den Mitarbeitern des zuständigen DKE/K 631 wiederholt bestätigt und im Rahmen des hierzu vorgesehenen Genehmigungsverfahrens durch den Technischen Beirat Internationale und Nationale Koordinierung (TBINK) der DKE befürwortet sowie durch die Geschäftsleitung des DIN gestattet. Diese Norm steht nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit Rechtsvorschriften und ist nicht als Sicherheitsnorm anzusehen.

Die Normenreihe IEC 62258 wurde zur Förderung der Produktion, Lieferung und Anwendung von Halbleiter-Chip-Erzeugnissen erstellt. Dieser Teil der Normenreihe legt die Datenformate für den Austausch von Daten fest und legt das Bauelemente-Datenaustausch-Format (device data exchange, DDX) mit dem Hauptziel fest, die Übertragung ausreichender geometrischer Daten zwischen Chiphersteller und CAD/CAE-Anwender beim Entwurf elektronischer Schaltungen zu ermöglichen, und formale Informationsmodelle, die den Datenaustausch in anderen Formaten ermöglichen.

Mindestanforderungen für die Daten, die zur Beschreibung der Chipzeugnisse für den Entwurf und die Beschaffung von Baugruppen notwendig sind, die speziellen Anforderungen an die Daten, die zur Beschreibung der geometrischen Eigenschaften von Halbleiter-Chip-Erzeugnissen notwendig sind, ihrer physikalischen Eigenschaften und der Anschlussmittel, die für ihre Anwendung bei der Entwicklung und Herstellung notwendig sind, sowie die entsprechende Terminologie und ein Verzeichnis häufiger Akronyme sind in DIN EN 62258-1 (VDE 0884-101):2011-04 angegeben.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 47 „Semiconductor devices“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Diesem Dokument liegt die Arbeit des vierten ESPRIT-Rahmen-Projektes „GOOD-DIE“ zugrunde, das zur Veröffentlichung der Reihe Europäische Spezifikationen ES 59008 führte, die durch die Reihe EN 62258 bzw. die Reihe IEC 62258 abgelöst wurde. An der Erarbeitung dieses Dokuments waren die Organisationen „ESPRIT ENCAST und ENCASIT Projekte“, „Die Products Consortium“, JEITA, JEDEC und ZVEI beteiligt.

In der Reihe IEC 62258 sind unter dem Titel „Semiconductor die products“ zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments folgende Teile veröffentlicht:

*Part 1: Requirements for procurement and use*

*Part 2: Exchange data formats*

*Part 3: Recommendations for good practice in handling, packing and storage (Technical Report)*

*Part 4: Questionnaire for die users and suppliers (Technical Report)*

*Part 5: Requirements for information concerning electrical simulation*

*Part 6: Requirements for information concerning thermal simulation*

*Part 7: XML schema for data exchange (Technical Report)*

*Part 8: EXPRESS model schema for data exchange (Technical Report)*

Weitere Teile können bei Bedarf hinzugefügt werden.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

### **Änderungen**

Gegenüber DIN EN 62258-2:2005-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Das Dokument wurde angepasst an die Version 1.3.0 des Datenaustauschformats DDX.
- b) Es wurden die im Vorwort der EN 62258-2 aufgeführten Parameter überarbeitet.

### **Frühere Ausgaben**

DIN EN 62258-2: 2005-12